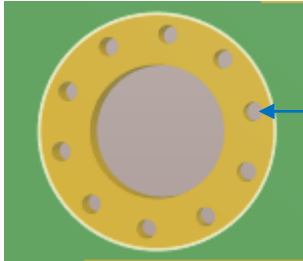


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES80100_V3	焊接	QM033221017	V3	1/2	20221017

一、MAIN 主板焊接要求

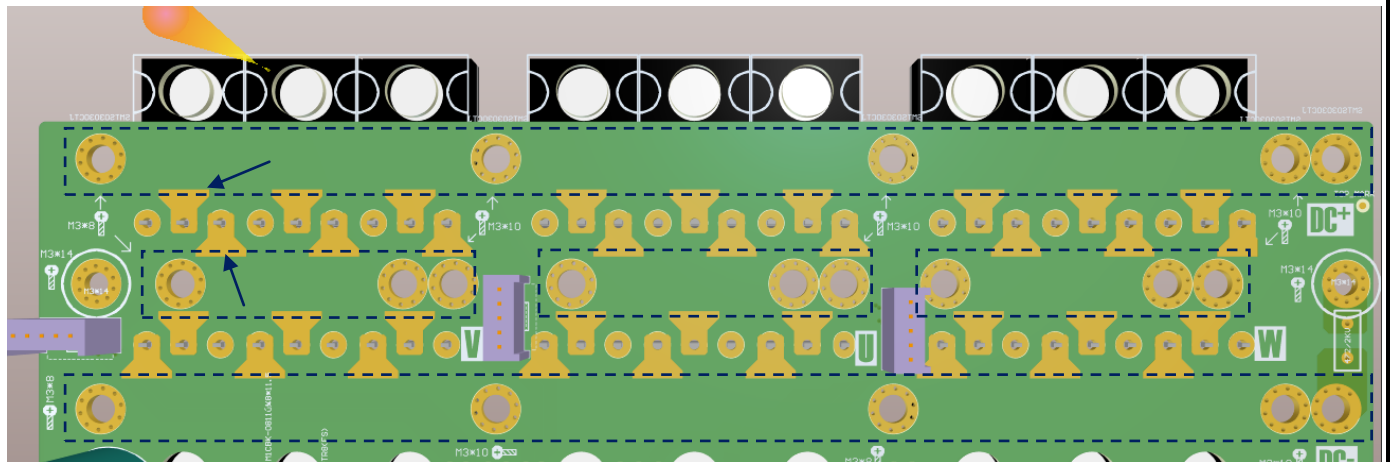
1 铜排固定孔焊接贴片螺母要求

1) 底层贴片螺母的焊盘孔周边一圈的小焊盘的焊锡，漏至顶层不能超过板面（焊锡可以稍欠缺一些）

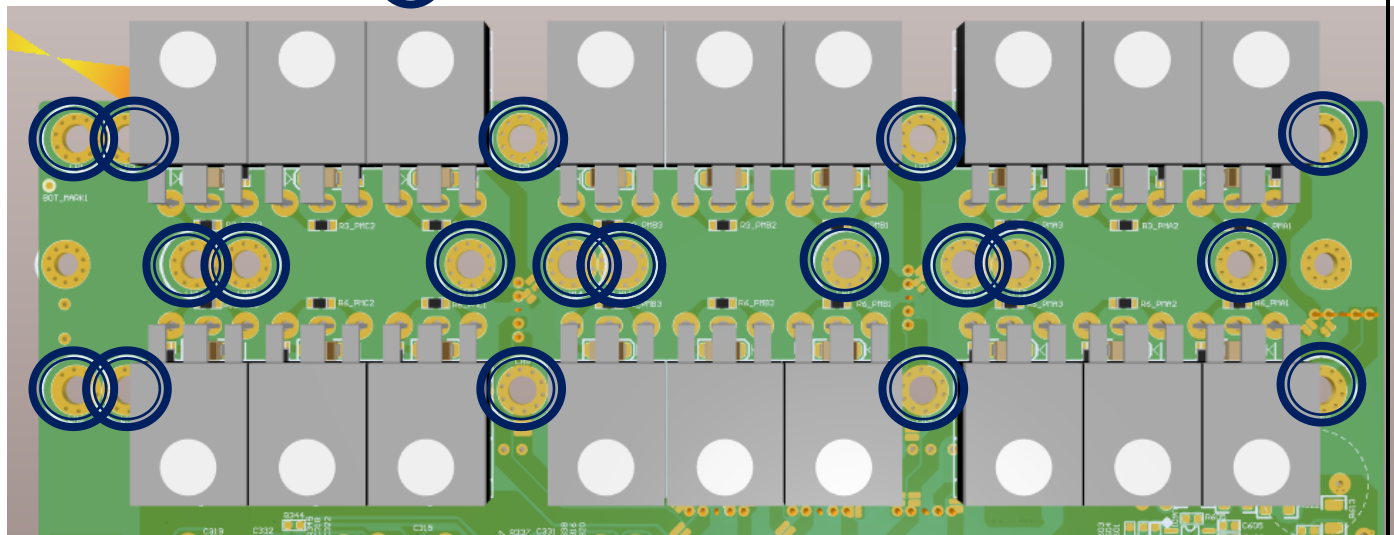


图示类似位置焊接贴片螺母（在底层），焊接时漏锡到此面（顶层），只要其漏锡不超过顶层面即可

2) 首先把铜排 5 根直铜排（虚线框）固定于 PCBA 上，再把 18 只 MOS 管的其中两个管脚 D,S 极，通过 PCB 上的“铲型”焊盘加锡与铜排相应焊接在一起（下图蓝色箭头所指）



2. 贴片螺母均贴装在底层  SMTS03030CTJ（红色字符为高度：030 为 3mm 高）



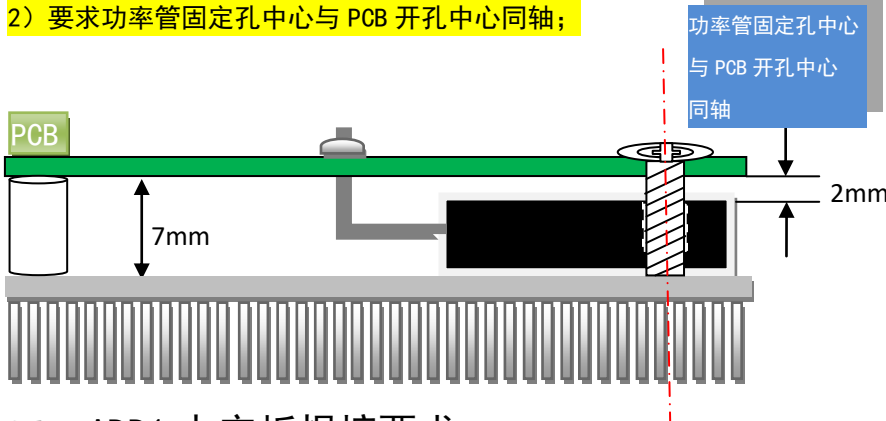
注意事项：

- 1) 贴片螺母焊接要求不能歪斜，必须垂直于 PCB 落到底部焊接；
- 2) 贴片螺母保证完全与 PCB 接触焊接（禁止浮高）；

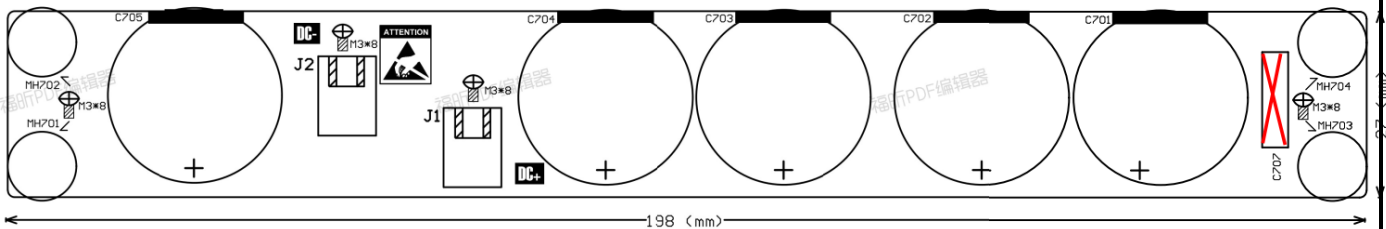
PCB 焊接	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
工艺要求	直流伺服	ARES80100_V3	焊接	QM033221017	V3	2/2	20221017

3. 红黑两色的风扇引线，分别焊接与 PCB 上 J3 对应的 R 和 B 焊盘孔
4. 功率管共计 18 个（T0-247 封装的管子）及 U202（T0-220 封装的管子）焊接要求：

- 1) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 7mm 焊接；
- 2) 要求功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴；



二、ADD1 电容板焊接要求



1. J1 和 J2 PCB 连接件确保焊接落位到底，且保证元件本体垂直于电容板，禁止浮高及虚焊现象
2. 电容管脚确保焊接良好，禁止虚焊
3. 所有插件的管脚剪切后长度不能超过 1.5mm（PCB 基准面算起的高度）

其他常规焊接要求

1. 所有端口插座焊接需要压到底焊接，不接受歪扭，偏差要小于 0.3mm；
2. 所有极性元件，严禁方向反；
3. 不接受虚焊，空焊，焊锡短路；
4. 未特殊说明的元件，均紧贴线路板焊接；
5. 手工操作要做防静电处理；
6. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准；
7. 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	